

- 3. RAM of more than 1,024 bits, or
 - 4. multiplication instructions,
- (IV) are capable of addressing storage off-the-chip of not more than 65,536 bytes,
- (V) have an operand or data word-length of less than or equal to 8 bits,
- (VI) have an ALU not wider than 8 bits, and
- (VII) are not rated for operation at ambient temperatures below -20°C or above 75°C ,

(J) storage monolithic integrated circuits or multichip integrated circuits, as follows:

(I) ROMs that

- 1. are mask-programmed by the manufacturer for a civil application prior to shipment,
- 2. have a maximum of 8,192 bits per package,
- 3. have a maximum access time of not less than 450 ns, and
- 4. are not rated for operation at ambient temperatures below -20°C or above 75°C ,

(II) PMOS ROMs and NMOS ROMs that

- 1. are mask-programmed by the manufacturer for a civil application prior to shipment,
- 2. have a maximum of 32,768 bits per package,
- 3. have a maximum access time of not less than 450 ns, and
- 4. are not rated for operation at ambient temperatures below -20°C or above 75°C ,

(III) PMOS ROMs and NMOS ROMs that

- 1. are mask-programmed or designed as character generators for a standard character font,
- 2. have a maximum access time of not less than 250 ns, and
- 3. are not rated for operation at ambient temperatures below -20°C or above 75°C ,

(IV) non-erasable PROMs that

- 1. are programmed by the manufacturer for a civil application prior to shipment,
- 2. have a maximum of 2,048 bits per package,
- 3. have a maximum access time of not less than 250 ns, and
- 4. are not rated for operation at ambient temperatures below -20°C or above 75°C ,

(V) non-erasable PROMs that

- 1. are programmed by the manufacturer for a civil application prior to shipment,

3. de RAM de plus de 1 024 bits,

4. d'instructions de multiplication,

(IV) sont capables d'accéder à une mémoire hors de la microplaquette d'au plus 65 536 multipléts,

(V) ont une longueur de mot d'opérande ou de donnée d'au plus 8 bits,

(VI) ont une ULA d'au plus 8 bits,

(VII) ne sont pas prévus pour fonctionner à des températures ambiantes inférieures à -20°C ou supérieures à 75°C ,

(J) circuits intégrés monolithiques ou circuits intégrés à microplaquettes multiples qui contiennent à la fois:

(I) des ROM qui à la fois:

- 1. sont programmées par masque par le fabricant pour une application civile avant expédition,
- 2. ont un maximum de 8 192 bits par boîtier,
- 3. ont un temps d'accès maximal d'au moins 450 ns,
- 4. ne sont pas prévues pour fonctionner à des températures inférieures à -20°C ou supérieures à 75°C ,

(II) un ou plusieurs PMOS, NMOS ou ROM qui à la fois:

- 1. sont programmés par masque par le fabricant pour une application civile avant expédition,
- 2. ont un nombre maximum de 32 768 bits par boîtier,
- 3. ont un temps d'accès maximal d'au moins 450 ns,
- 4. ne sont pas prévus pour fonctionner à des températures ambiantes inférieures à -20°C ou supérieures à 75°C ,

(III) un ou plusieurs PMOS, NMOS ou ROM qui à la fois:

- 1. sont programmés par masque ou conçus pour la génération de caractères pour une police de caractères standard,
- 2. ont un temps d'accès maximal d'au moins 250 ns,
- 3. ne sont pas prévus pour fonctionner à des températures ambiantes inférieures à -20°C ou supérieures à 75°C ,

(IV) une ou plusieurs PROM non effaçables qui à la fois:

- 1. sont programmées par le fabricant pour une application civile avant expédition,
- 2. ont un nombre maximum de 2 048 bits par boîtier,
- 3. ont un temps d'accès maximal d'au moins 250 ns,
- 4. ne sont pas prévues pour fonctionner à des températures ambiantes inférieures -20°C ou supérieures à 75°C ,

(V) une ou plusieurs PROM non effaçables qui à la fois:

- 1. sont programmées par le fabricant pour une application civile avant expédition,